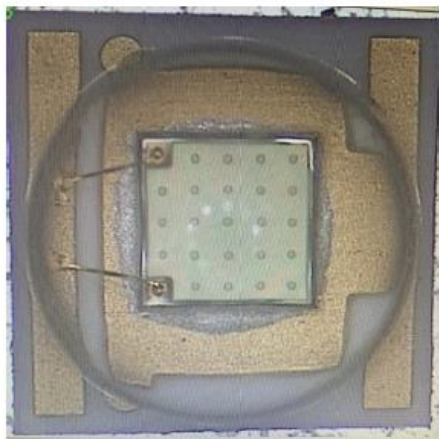




产品介绍

本系列产品采用高可靠性氧化铝陶瓷基板做衬底，线路采用 DPC 镀金工艺、使用垂直晶片，具有使用寿命长、永不硫化、溴化等特点

产品特点:

- ✧ 高亮度、高可靠性、高使用寿命
- ✧ 发光角度: 120°
- ✧ 波段: 450-460nm
- ✧ 符合ROHS 标准

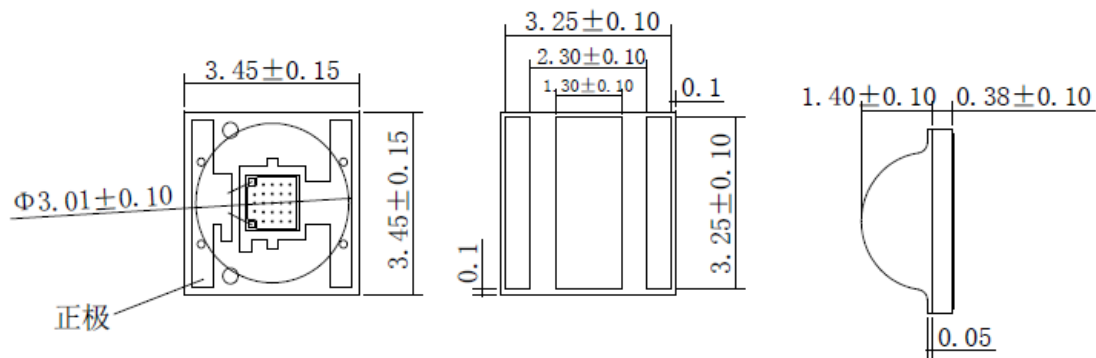
目录

外形尺寸	3
电路结构.....	3
极限参数	4
光电参数	4
典型特性曲线	5
可靠性测试	6
包装规范.....	7
推荐回流焊温度.....	8

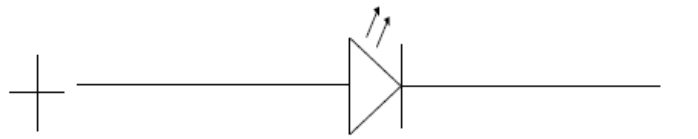


SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

Part No: SEL-3535-B-3V350



电路结构



1P1S

说明:

- ◇ 所有尺寸标注单位都是毫米
- ◇ 若无标注尺寸, 公差按 $\pm 0.2\text{mm}$
- ◇ 建议基板 T_s (焊盘) 的温度不要高于 100°C
- ◇ 产品的外观和规格会不断优化, 恕不另行通知



极限参数（Ta = 25℃）

参数	符号	测试条件	参数		单位
			最小	最大	
直流电流	I _F	----	----	1000	mA
脉冲电流	I _{peak}	占空比=1/10 1kHz	----	1100	mA
LED 结温	T _J	----	----	130	℃
工作环境温度	T _{opr}	----	-10	+100	℃
储存温度	T _{str}	----	-40	+100	℃
焊接温度	----	----	260 (<5S)		℃

光电参数（Ta = 25℃）

波段	参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
450-460	正向电压	V _F	I _F = 350mA	2.8	--	3.1	V
	光通量	Φ _v		--	20	--	lm
	波段范围	CCT		450	455	460	nm
	发光角	2θ _{1/2}		--	120	---	°
	功率	W		--	1	--	W



SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

Part No: SEL-3535-B-3V350

典型特性曲线：

Fig.1 Forward Current(mA) Vs Forward Voltage(V)

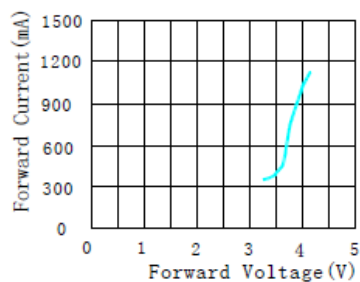


Fig.2 Relative Intensity Vs Forward Current (mA)

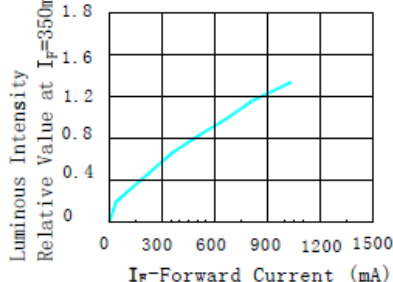


Fig.3 Forward Current Vs Ambient Temperature

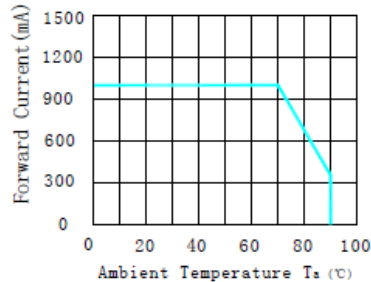
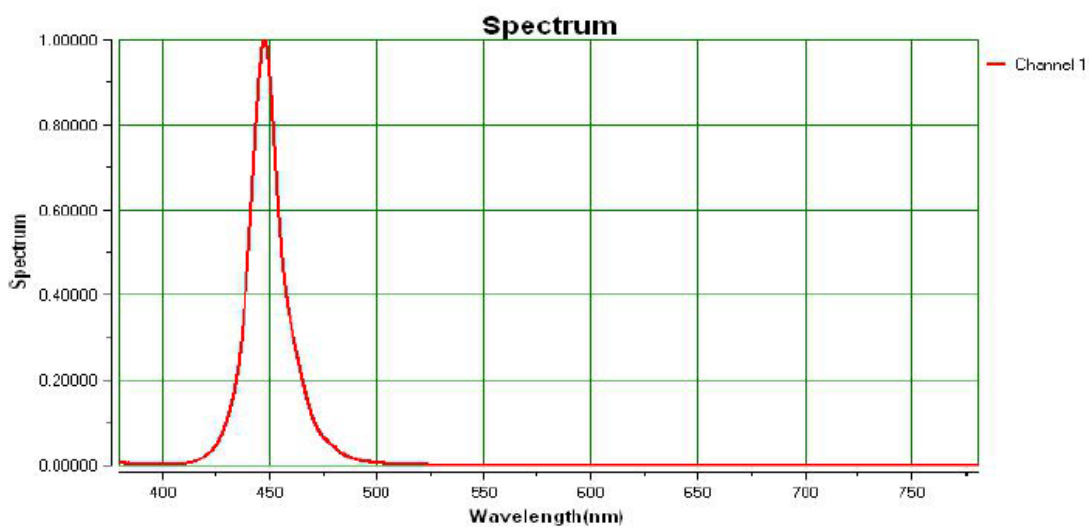
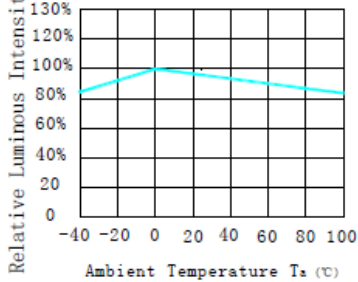


Fig.4 Relative Intensity Vs Ambient Temperature





SUNSHINE ELECTRONICS TRADING LIMITED

Part No: SEL-3535-B-3V350

可靠性测试

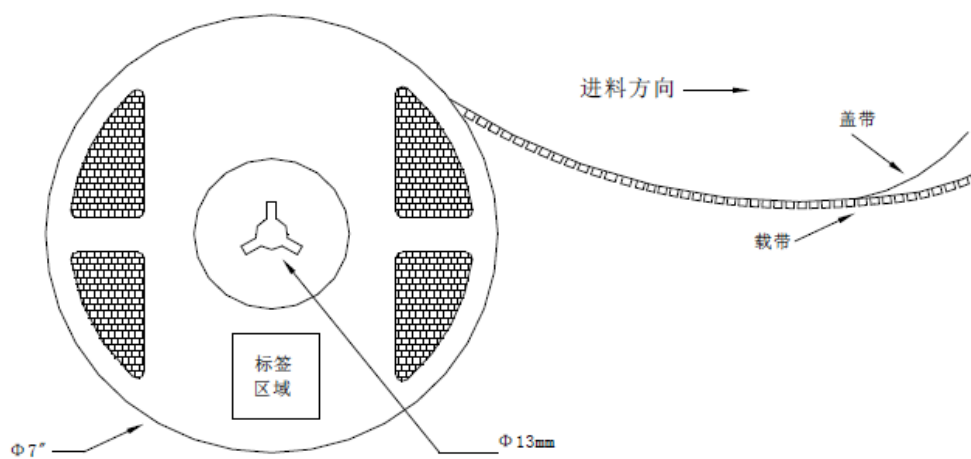
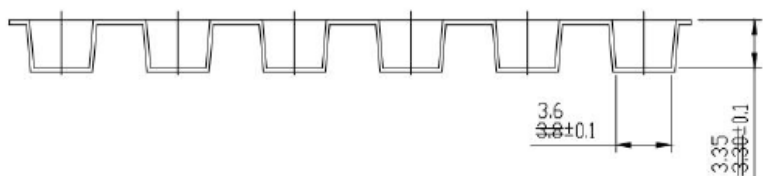
测试项目	参考标准	测试条件	测试时间	Units 失败/成功
循环温度测试	JEITA ED-4701 100 105 或 MIL-STD-202G	-40℃ (30 分) ∽ 25℃ (5 分) ∽ 100℃ (30 分) ∽ 25℃ (5 分) 或 -40℃ (30min) ∽ 100℃ (30min)	100 次	0/10
高温存贮	JEITA ED-4701 200 201	T _a =100℃	1000 小时	0/10
存储的温度与湿度	JEITA ED-4701 100 103	T _a =60℃ RH=90%	1000 小时	0/10
低温存储	JEITA ED-4701 200 202	T _a =-40℃	1000 小时	0/10
高温使用寿命		T _c =130℃ I _r =最大电流	1000 小时	0/10
静电放电	JEITA ED-4701 300 304	HBM 8KV 3KΩ 脉冲频率: 100 3 次反向脉冲		0/10
循环温度 *1	升谱	-40℃ (30 分) ∽ (90 秒) ∽ 140℃ (30 分) ∽ (90 秒) -40℃	1000 次	0/10
高温高湿测试*2	升谱	T _a =100℃ RH=85% I _r =最大电流	1000 小时	0/10

注意:

保证器件温度是室温的情况下进行测试

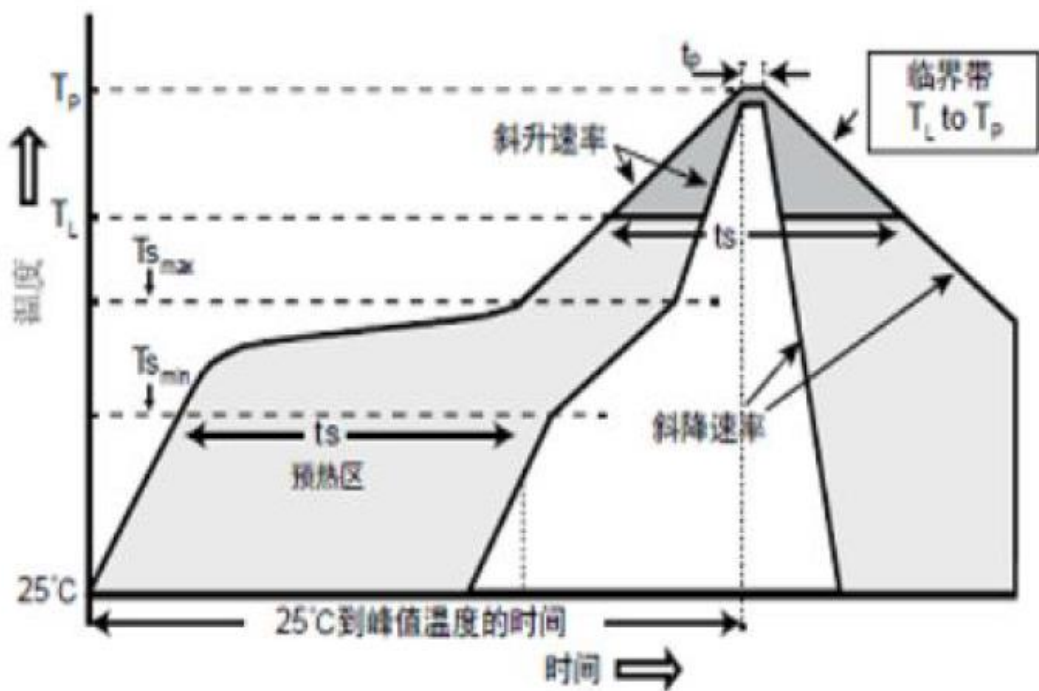


包装规范





推荐回流焊温度曲线



温度分布特点	锡铅共晶焊料	无铅焊料
斜升速率 (TSmax 到 TP)	最大值 3℃/秒	最大值 3℃/秒
最低预热温度 (TSmin)	100℃	150℃
最高预热温度 (TSmax)	150℃	200℃
预热时间 (TSmin 到 TSmax)	60-120 秒	60-180 秒
液相温度 (TL)	183℃	217℃
温度维持在 TL 以上时间	60-150 秒	60-150 秒
封装体峰值温度 (Tp)	215℃	260℃
指定实际峰值温度 5℃ 内的时间	10-30 秒	20-40 秒
斜率速率 (Tp 到 TL)	最大值 6℃/秒	最大值 6℃/秒
25℃ 到峰值温度的时间	最大值 6 分钟	最大值 8 分钟